

# 2014年3月期 第3四半期(2013年4月～12月) 東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 第3四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 事業計画の見直しと2014年3月期の業績予想について

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年1月30日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/January 30, 2014



# 第3四半期連結決算の概要

---

取締役執行役員 原田 芳輝

2014年1月30日

# 損益状況

(億円)

	2014年3月期			1Q-3Q		
	1Q	2Q	3Q	FY14	FY13	前年同期比
売上高	1,034	1,510	1,384	3,929	3,585	+10%
売上総利益	299	501	503	1,303	1,138	+14%
下段: 売上総利益率	28.9%	33.2%	36.4%	33.2%	31.8%	
販管費	395	423	412	1,231	1,085	+13%
営業利益	-96	78	90	72	53	+36%
下段: 営業利益率	-9.3%	5.2%	6.6%	1.8%	1.5%	
税前利益	-98	95	-372	-375	93	-468億円
当期純利益	-29	54	-380	-356	-9	-346億円
研究開発費	179	204	189	573	548	+5%
設備投資額	47	19	14	82	188	-56%
減価償却実施額	63	64	58	186	184	+1%

## 減損により3Qに特別損失457億円を計上

(1) PVE事業	のれんおよび固定資産の全額減損 326億円
(2) TEL NEXX事業	のれんおよび無形資産の減損 50億円 (期末資産価値142億円)
(3) 拠点再編	固定資産の減損 80億円

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

# 部門別売上高

(億円)

	2014年3月期						1Q-3Q				
	1Q		2Q		3Q		FY14		FY13		前年 同期比
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	
SPE	749	72%	1,198	79%	1,022	74%	2,970	76%	2,827	79%	+5%
FPD	49	5%	44	3%	88	6%	182	5%	138	4%	+32%
PVE	20	2%	12	1%	11	1%	44	1%	0	0%	---
EC/CN	214	21%	253	17%	260	19%	728	18%	615	17%	+18%
その他	1	0%	1	0%	0	0%	3	0%	3	0%	+10%
合計	1,034	100%	1,510	100%	1,384	100%	3,929	100%	3,585	100%	+10%

## ■ SPE

(半導体製造装置)

事業環境は引き続き堅調。3Qはメモリ向けが売上を牽引。

## ■ FPD

(FPD製造装置)

売上の中心は中国。3Qより大型パネル用第8世代製造装置売上に回復の兆し。

## ■ PVE

(太陽光パネル製造装置)

引き続き厳しい事業環境。

## ■ EC/CN

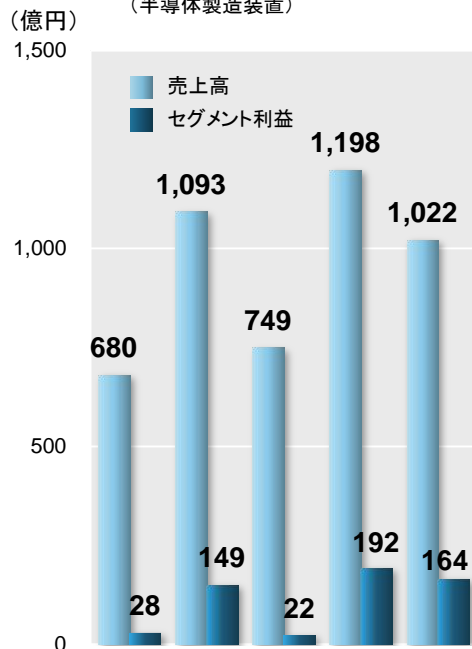
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

産業機器関連の市況の好転により汎用IC中心に売上増加。

# セグメント情報

## SPE

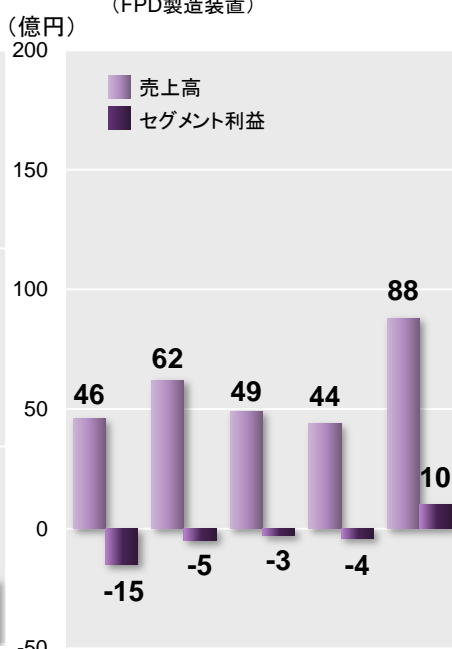
(半導体製造装置)



	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q
セグメント利益率	4.2%	13.7%	3.0%	16.1%	16.0%

## FPD

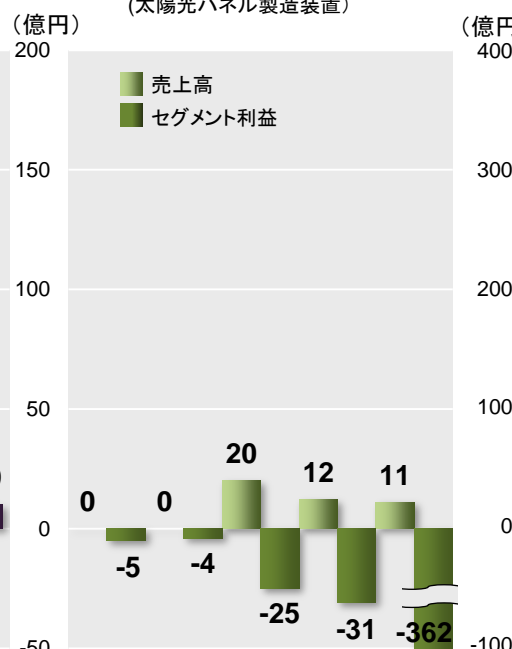
(FPD製造装置)



	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q
セグメント利益率	-32.1%	-8.6%	-6.3%	-10.0%	11.9%

## PVE

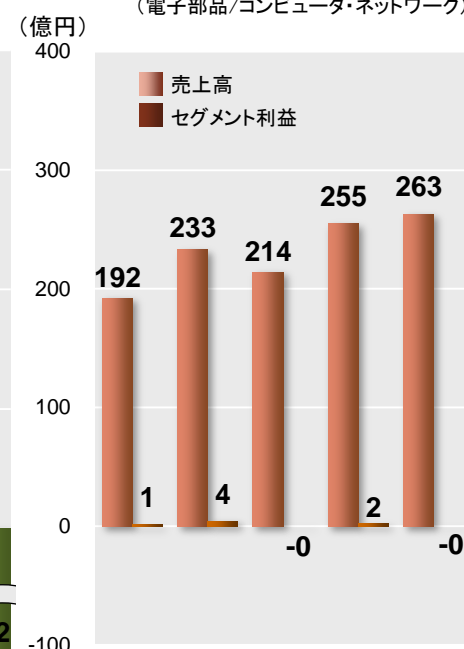
(太陽光パネル製造装置)



	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q
セグメント利益率	-	-	-124.7%	-257.1%	-

## EC/CN

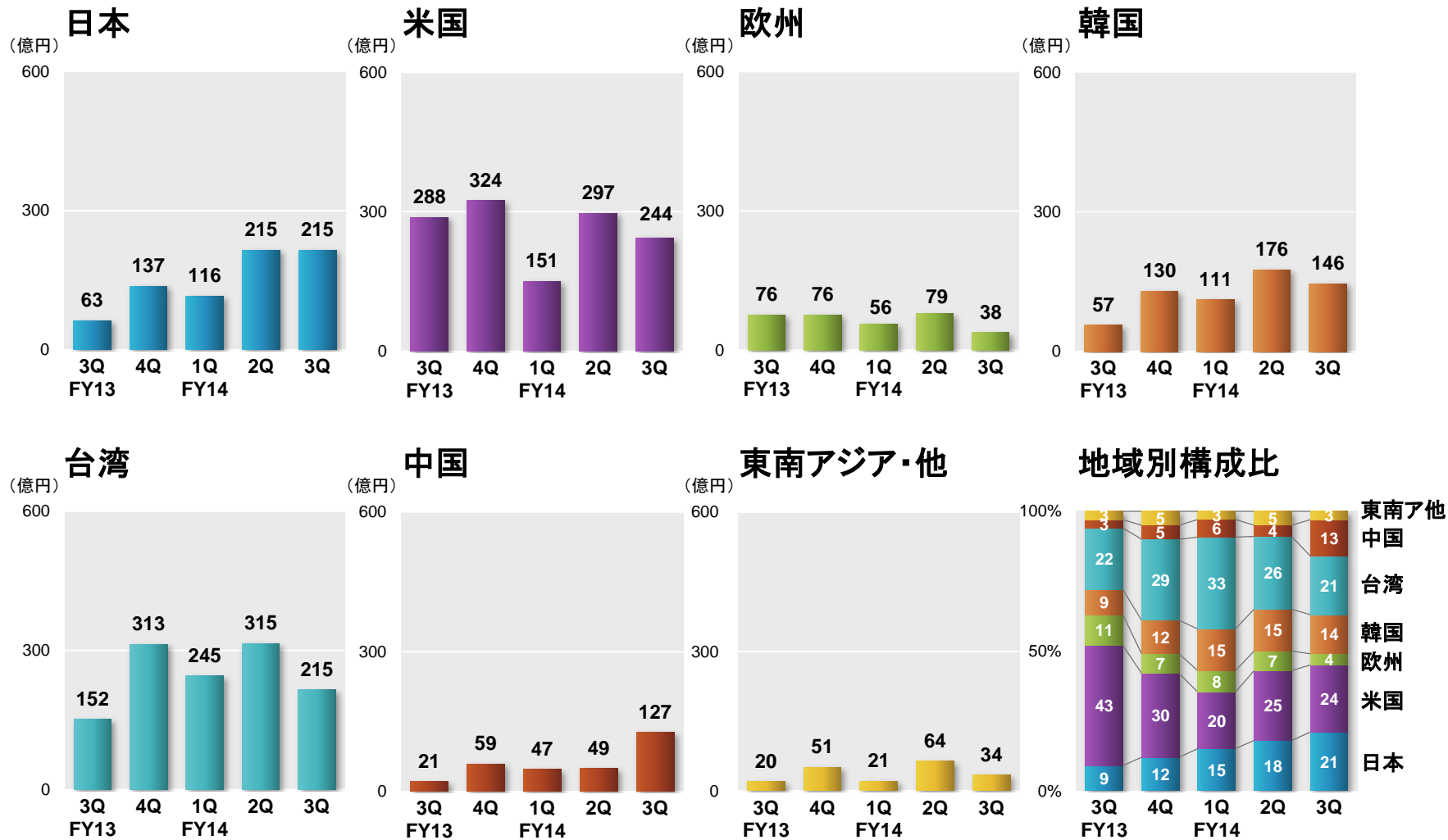
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)



	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q
セグメント利益率	1.0%	1.8%	-0.1%	1.0%	-0.1%

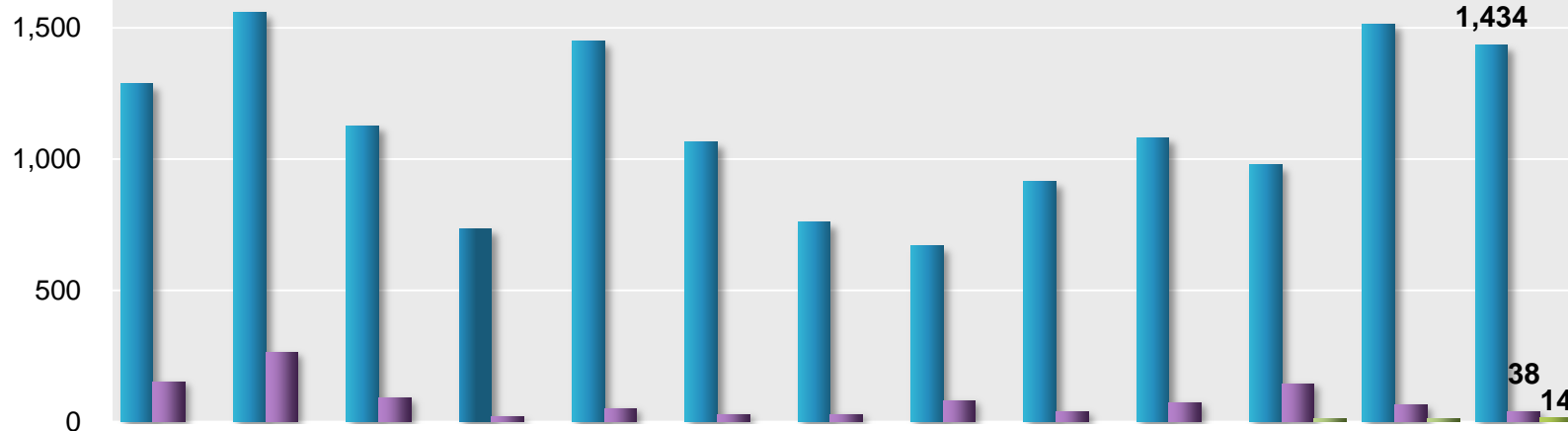
1. 従来のFPD/PVEセグメントを、当第1四半期よりFPDとPVEに分けて開示いたします。FY2013については遡及し、組み替えて表示しています。
2. セグメント利益は、税前利益です。
3. 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。

# SPE部門地域別売上高



# 受注額・受注残高

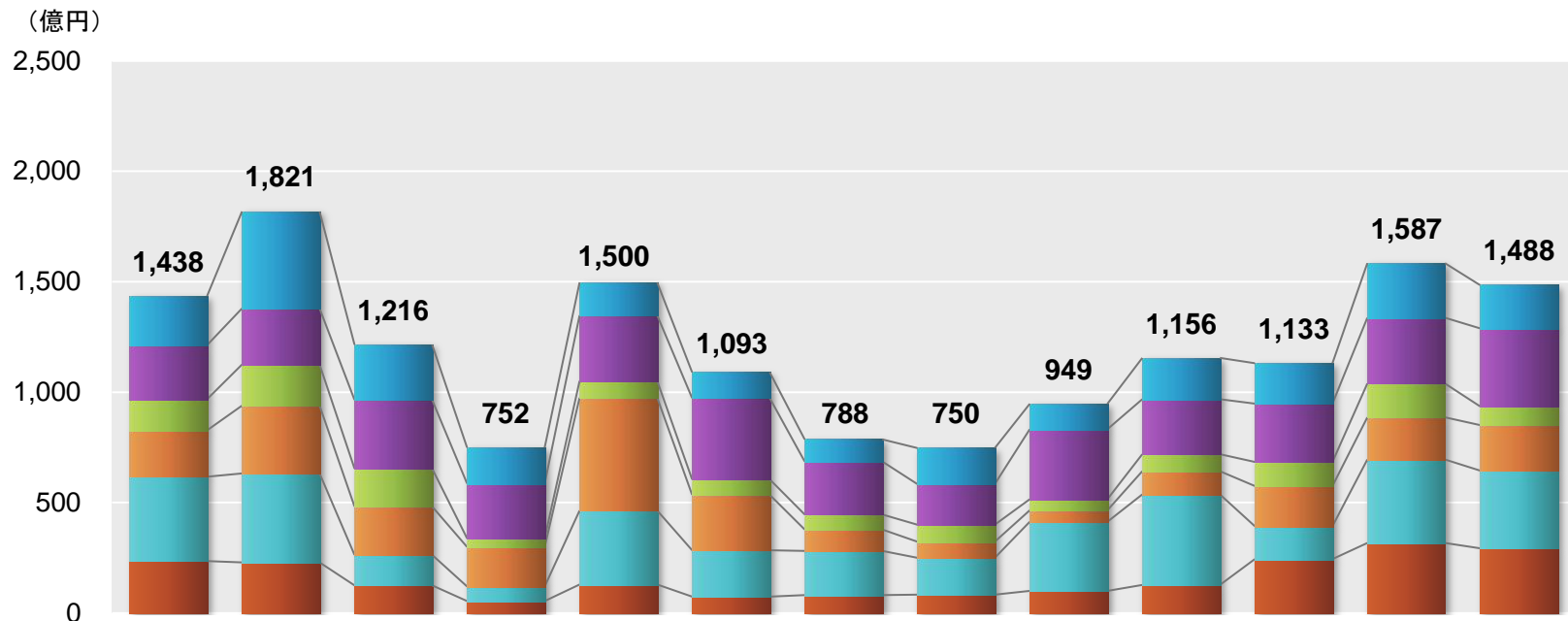
(億円)  
2,000



	FY11 3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q
■ SPE受注額	1,286	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434
■ FPD受注額	152	263	89	17	50	28	27	80	36	73	144	63	38
■ PVE受注額							0	0	0	0	11	11	14
SPE受注残高	2,288	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372
FPD受注残高	510	654	618	394	278	142	122	158	148	160	255	274	225
PVE受注残高							0	-	84	84	76	74	77

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

# 地域別受注額：SPE+FPD+PVE



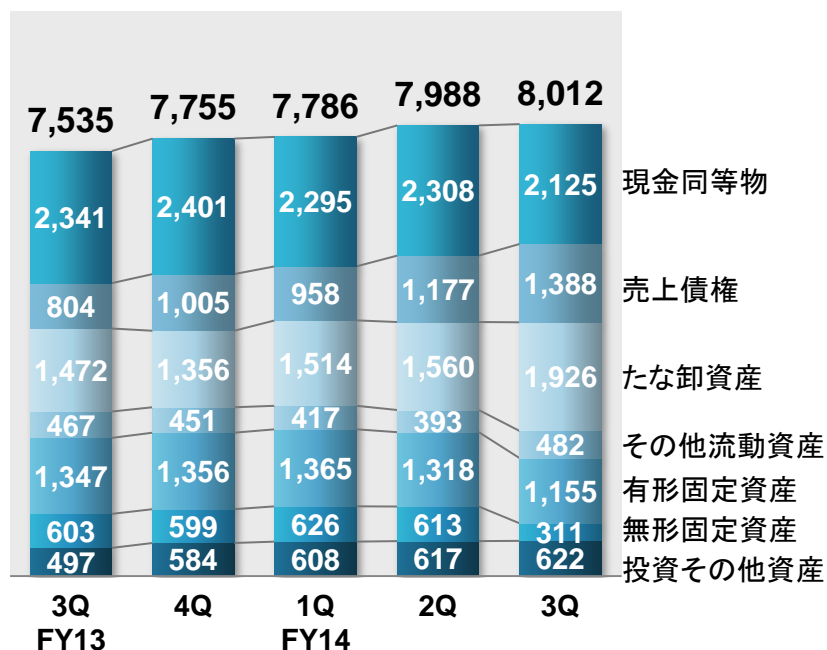
	FY11 3Q	FY11 4Q	FY12 1Q	FY12 2Q	FY12 3Q	FY12 4Q	FY13 1Q	FY13 2Q	FY13 3Q	FY13 4Q	FY14 1Q	FY14 2Q	FY14 3Q
国内	222	439	250	163	149	117	100	163	115	187	183	247	196
米国	245	254	311	248	297	368	240	184	317	249	264	298	353
欧州	141	186	172	39	76	70	68	77	50	77	109	153	85
韓国	210	307	219	179	511	251	97	73	52	105	182	191	206
台湾	382	403	137	66	335	210	200	167	313	410	149	378	352
中国・東南ア他	235	229	125	54	129	74	81	83	100	127	244	317	293



# 貸借対照表

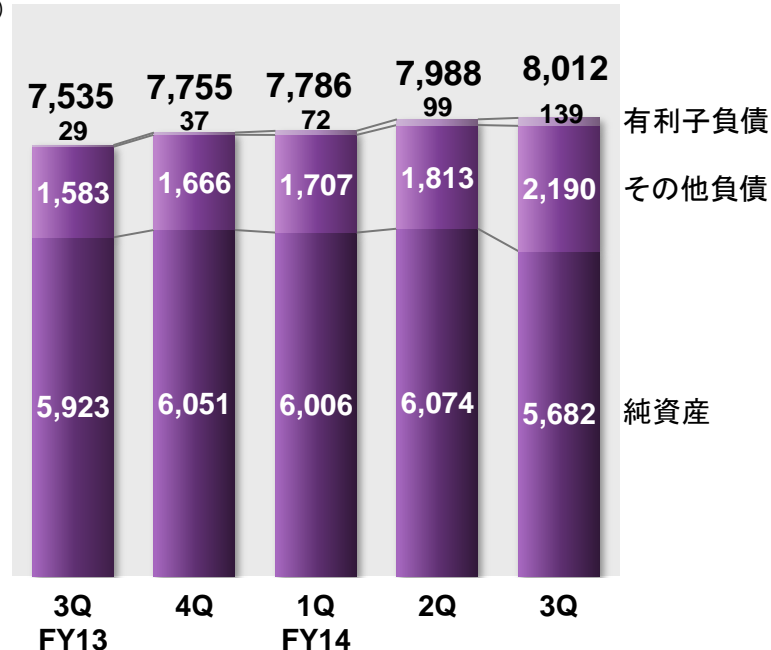
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

(億円)



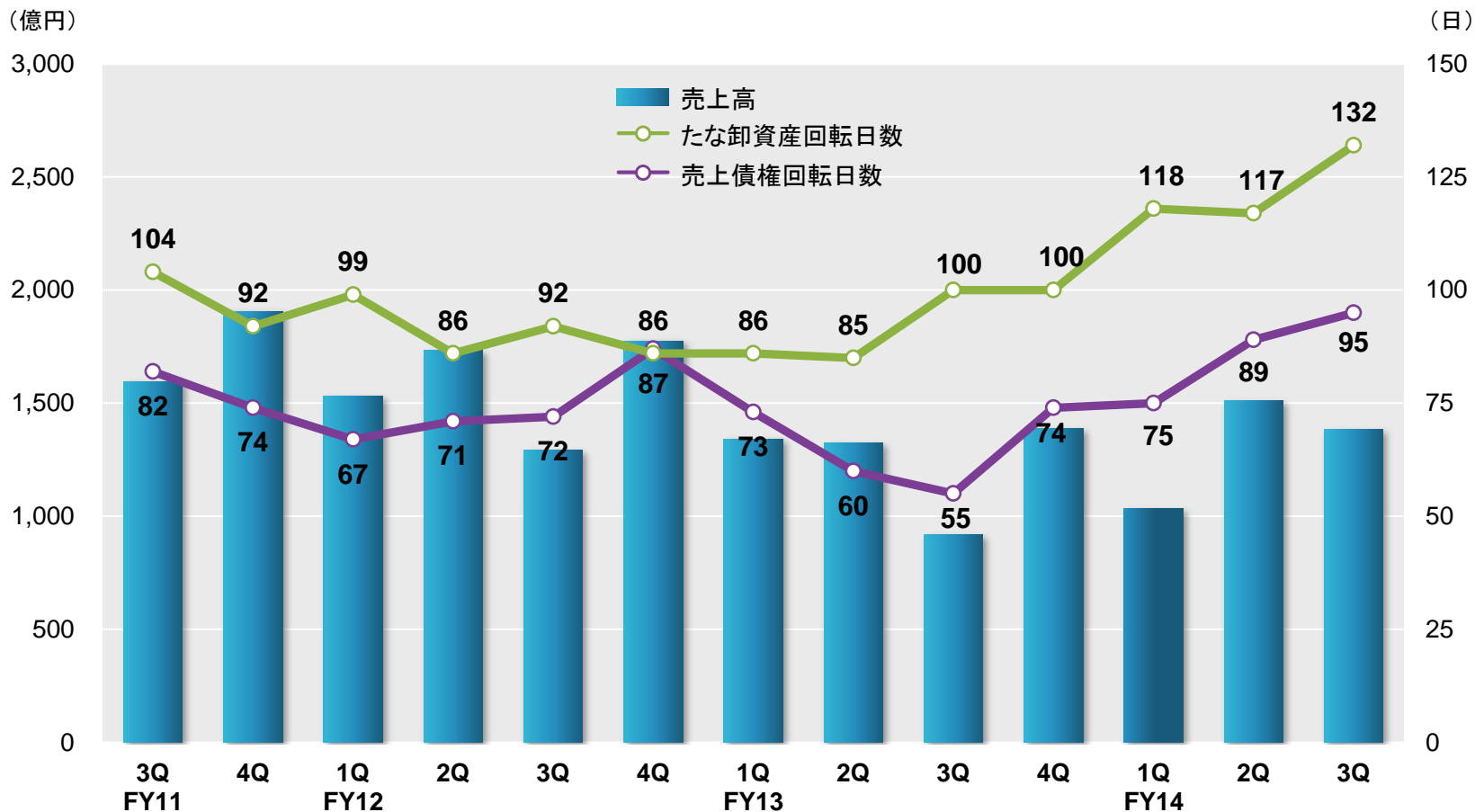
前四半期(2Q)からの主な増減

(億円)

		増減	主な要因
資産	たな卸資産	+366	出荷済み未設置在庫の増加
	有形固定資産	-162	減損－拠点再編(-80), PVE(-9) 減価償却(-58)
	無形固定資産	-302	減損－PVE(-316), NEXX(-50)
負債	その他負債	+376	前受金の増加(+198)
	純資産	-392	当期純損失(-380), 中間配当(-44), 為替換算調整勘定(+29)

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は「有価証券」)

# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

	2013年3月期 1Q-3Q	2014年3月期 1Q-3Q	(億円)
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	<b>716</b>	<b>△121</b>	
税引前利益	93	△375	
減価償却費	184	186	
減損損失	0	465	
売上債権の減少(△増加)	759	△347	
たな卸資産の減少(△増加)	68	△533	
仕入債務の増加(△減少)	△202	125	
法人税等の支払額または還付額	△52	△5	
その他	△134	363	
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	<b>△1,504</b>	<b>167</b>	
設備投資	△155	△69	
企業買収に伴う株式取得等による支出	△561	-	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	△800	254	
その他	13	△16	
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	<b>△113</b>	<b>2</b>	
配当金支払い	△93	△91	
その他	△20	93	
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>653</b>	<b>831</b>	
<b>満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高</b>	<b>1,688</b>	<b>1,293</b>	
<b>現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高</b>	<b>2,341</b>	<b>2,125</b>	



# 事業計画の見直しと2014年3月期の 業績予想について

---

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年1月30日

---

# 市場環境



TOKYO ELECTRON

CORP IR/January 30, 2014



# 事業環境

## ▶ 半導体設備投資

CY2014の半導体前工程(WFE)の設備投資は、前年比10%の増加を見込む。スマートフォン、タブレットの需要は依然堅調であり、メモリ、ロジック向け共に設備投資が増大すると予測。

- DRAM: スマートフォン、タブレットの堅調な需要が継続して投資を牽引
- NAND: モバイル機器向けに加えて、SSD向けの投資が拡大
- ロジック/ファウンドリ: 20/16nm 先端ロジック向け投資が拡大

## ▶ FPD設備投資

CY2014の液晶パネル用製造装置の需要は、中国においては20%強の増加が見込まれるものの、全体としては前年同水準を見込む。また、有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降。

(2014年1月時点での見方)

# 四半期 受注額

(億円)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

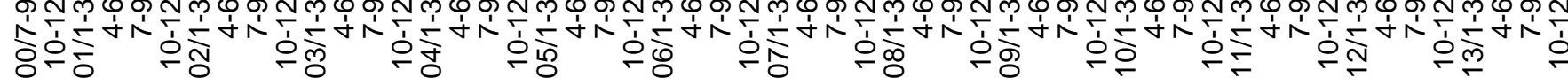
0

■ 半導体製造装置 (SPE) ■ FPD製造装置 ■ PV製造装置

## 2013/10-12月期

SPE	1,434億円 (-5%)
FPD	38億円 (-39%)
PVE	14億円 (+31%)
合計	1,488億円 (-6%)

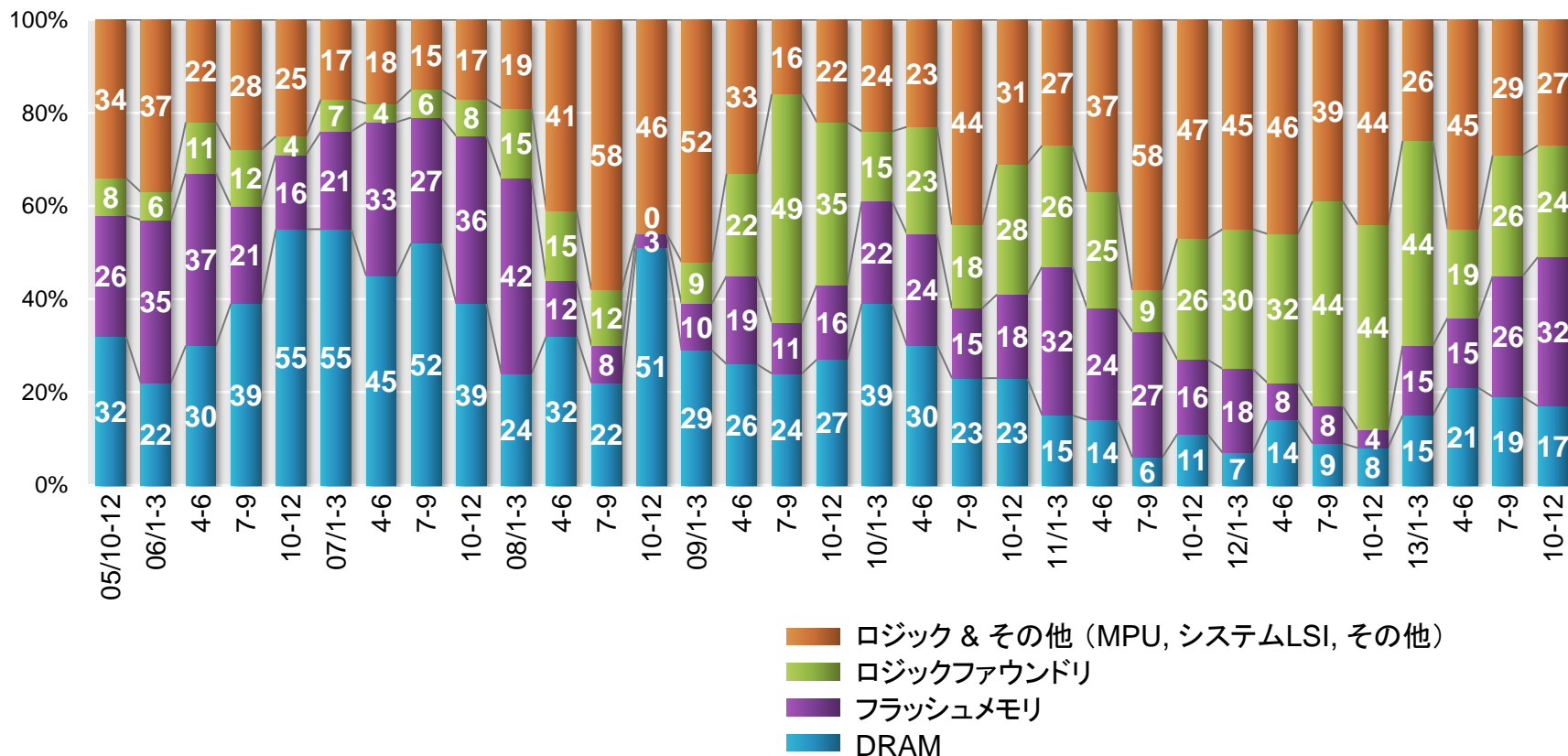
( )内%は 2013/7-9月期からの増減  
増減率は1円単位の数字を元に計算



2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は  
FPD製造装置の値に含まれています。



# 四半期 アプリケーション別SPE受注



グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

---

# 2014年3月期 業績予想



TOKYO ELECTRON

CORP IR/January 30, 2014



# 2014年3月期 業績予想(2013/12/18発表から変更なし)

(億円)

	FY2013	FY2014					
		上期	下期		通期		通期 対前年 増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	4,972	2,545	3,505	-	6,050	-	+22%
SPE	3,920	1,947	2,803	-	4,750	-	+21%
FPD	200	93	167	-	260	-	+30%
PVE	0	32	38	-	70	-	-
EC/CN	846	467	498	-	965	-	+14%
その他	4	2	3	-	5	-	+12%
営業利益	125	-18	318	-	300	-	+174
下段: 営業利益率	2.5%	-0.7%	9.1%	-	5.0%	-	+2.5pts
税前利益	177	-3	-146	-469	-150	-469	-327
当期純利益	60	24	-244	-450	-220	-450	-280

\*修正額: 2013/10/23に発表した業績予想からの修正額を示しています。

PVE事業等に関する特別損失を計上、業績予想を下方修正

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

18

# 業績予想に関連して

1. 2013/12/18発表の特別損失457億円を3Qに計上
  - PVE事業に関するのれんおよび固定資産の減損 326億円
  - TEL NEXX 事業に関するのれん等の減損 50億円
  - 拠点再編計画に伴う固定資産減損 80億円
  
2. 配当予想について
  - 1株当たり年間配当50円を据え置く(中間25円、期末25円)

特別損失等の計上により、年間換算で約66億円の償却費等の削減を見込む

# PVE事業からの撤退について

## 1. 撤退の理由

- 厳しい事業環境のなか、製品競争力向上、コスト削減に取り組んできたが、今後も投資回収が見込めなくなったため。

## 2. 撤退の概要

- 2014年3月末をもって開発・製造・販売活動を停止。  
納入済み装置のサポート業務のみ継続。
- 従業員はグループ内で再配置、スイス現地法人の社員は、事業規模に合わせて削減予定。

## 3. 当期損益への影響

- のれん、固定資産の減損326億円を3Qに計上。

---

# Applied Materials (AMAT)との 経営統合に向けた進捗



# AMATとの経営統合に向けた進捗

1. 合併直後から最適なオペレーションを開始するための統合検討チーム(IMO)を発足
2. 両社の合併に関する登録届出書(Form S-4 registration statement)を米国証券取引委員会(SEC)に提出予定
3. 統合完了に必要な要件
  - 各国当局による競争法の承認
  - 両社株主総会での決議

統合完了は、2014年の半ばから後半を予定

# まとめ

---

1. CY2014の半導体前工程製造装置市場は、前年比10%の増加を見込む。メモリ、ロジック共に顧客の投資意欲は旺盛。技術変換点に対応する製品を投入し、収益拡大に取り組む。
2. PVEは、事業撤退を決定。全社の利益改善を目指す。
3. AMATとの経営統合完了は、予定通り2014年の半ばから後半を見込む。



## ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

## ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

## ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

# 50 Years